

Title (en)

Alcaline chemical copper plating bath.

Title (de)

Alkalisches aussenstromloses Kupferbad.

Title (fr)

Bain alcalin de dépôt chimique de cuivre.

Publication

EP 0251302 A2 19880107 (DE)

Application

EP 87109422 A 19870630

Priority

DE 3622090 A 19860702

Abstract (en)

The bath containing copper salt, reducing agent, wetting agent, alkali metal hydroxide and complexing agent can be prepared free of cyanide and, if desired, also free of formaldehyde, if it contains, as a complexing agent N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)- ethylenediamine, a thioalcohol or a thiocarboxylic acid and a salt of gallium, indium and/or thallium.

Abstract (de)

Ein alkalisches außenstromloses Kupferbad enthaltend Kupfersalz, Reduktionsmittel, Netzmittel, Alkalihydroxid und Komplexierungsmittel kann cyanidfrei und gewünschtenfalls auch formaldehydfrei hergestellt werden, wenn es als Komplexierungsmittel N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)-ethylendiamin, Thioalkohol oder eine Thiocarbonsäure und ein Gallium-, Indium- und/oder Thalliumsalz enthält.

IPC 1-7

C23C 18/40

IPC 8 full level

C23C 18/40 (2006.01)

CPC (source: EP)

C23C 18/40 (2013.01)

Cited by

EP1286576A3; CN100402700C; EP1411147A1; US7892413B2; US8425753B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

DE 3622090 C1 19900215; EP 0251302 A2 19880107; EP 0251302 A3 19880727

DOCDB simple family (application)

DE 3622090 A 19860702; EP 87109422 A 19870630